

インタビュー FICT(株) 代表取締役社長 雨宮隆久氏 テスター向け需要が回復 3年後に売上高400億円へ



FICT(株)（長野市）は、大型の半導体パッケージ基板や半導体プローブカード向けなど、超高多層／高アスペクト比関連の高難易度基板製造を得意とする。チップレットや光電融合など次世代の高機能・高集積デバイスの普及を見据え、多層ガラス基板の製法も確立した。半導体市場の軟調が続くなか、足元の市況や2024年度の事業展望について同社の雨宮隆久社長に話を聞いた。

―23年度の総括から。

雨宮 コロナ特需の反動もあってPCなどの販売の戻りが鈍く、半導体も一部のデバイスを除き回復が遅れた。しかし、年度後半からは半導体テスター関連向けの超高層基板の受注が回復して、製品ミックスも改善された。それまでの高水準の受注残も手伝って、売上高は前年度比横ばいの3

00億円弱を計上した。

―足元の市況感は。

雨宮 データセンター向けのサーバーに搭載される高多層板は堅調だ。プローブカード向けスペーストランスフォーマー（ST）や半導体テスト装置向けにも高アスペクト比で高多層板の需要が拡大している。サーバー用CPU向けの大型パッケージ基板は在庫調整の影響で下期から回復すると予想する。24年度は2桁成長を見込む。

―事業構成について。

雨宮 当社の事業構成は、①高多層基板事業、②半導体関連（プローブカード、半導体パッケージ基板など）事業、③高精度加工（穴あけ・ルーター加工）事業の3分野である。従来、高アスペクト比のプローブカード向けやハイエンドサーバー向けなどの高多層基板領域を中心に事業を拡大してきたが、最近は高機能デバイス向けの大型パッケージ基板にも注力している。

―全層IVH構造が可能な独自工法のFALCS（エフ・アルシス）が注目されています。

雨宮 用途が広がっている。高速伝送に対応しており、めっきレスの先端技術だ。当社のシェアが高いSTのほか、半導体検査関連装置向けなどの40層を超える超高多層基板で顧客が増えている。次世代のルーターや高性能サーバー向けなどにも売り込み、さらに用途の拡大を図りたい。

めっきを使わないビア接続技術もポイントで、環境負荷が非常に小さい製造技術である。製造工程も従来比で半減でき、納期短縮に貢献する。導電性ペースト充填と金属間接合でビアを任意に形成でき、高密度化対応が容易だ。

―ガラス多層基板も開発済みです。

雨宮 基本技術は、当社が開発したFALCSがもとになっている。導電性ペーストは材料メーカーと共同開発したもので、強固なビア接続を実現できる。次世代のチップレットニーズに対応した大型パッケージ基板や光電融合モジュール向けのコ・パッケージ技術などへの適用を目指している。現在様々な方々から問い合わせや引き合いをいただいております、事業拡大に向けて組めるところがあれば、アライアンスも効果的に活用していきたい。

―足元の投資は。

雨宮 長野本社工場ではこれまでに微細化に対応するため、既存のSAPラインの高度化やビルドアップ工程に向けた戦略投資を行っている。一方、黒姫事業所では、受託事業でもある穴あけ加工の新棟整備

を精力的に行ってきた。足元の市況低迷を受け、いったん投資のペースを緩めている。市況を見定めながら追加投資を検討したい。例えば穴あけ装置を多軸タイプのものに切り替えたり、効率的な投資を行っていく。

—新たな中期経営計画も策定しました。

雨宮 24～26年度の3カ年でスタートしている。次の売上目標としてまずは400億円を見込む。このうち新規アプリケーションや新規顧客向けで3割程度を売り上げたい。多少の生産ラインの増強はあるかもしれないが、大きな新規投資をせずとも、前中計（21～23年度）までに実施した案件で対応できそうだ。まずは営業キャッシュをしっかりと確保し、次の成長に備える。なお、長野本社工場も、将来的な成長を達成するうえでは必要と判断して富士通側から取得済みだ。

（聞き手・特別編集委員 野村和広）